

## 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム

### 産学共同(育成型) 事後評価結果

体系的課題番号	: JPMJTR20RC
採 択 年 度	: 2020 年度
分 野	: ICT・電子デバイス、ものづくり分野
研究開発課題名	: 次世代パワー半導体デバイス実現に資する高信頼性焼結型接合技術の開発
プロジェクトリーダー 研究責任者	: 西川 宏(大阪大学)

#### 評価結果の総合所見

本課題は、次世代パワー半導体モジュールの高性能化に向け、耐熱性と放熱性に優れた接合技術の開発を目指すものである。

当初の目標は達成しているが、競合優位性の面から次の研究開発に移行できるかは課題が残った。今後の取り組み次第では企業との共同研究につながる可能性がある。

実用化を目指すためには、メカニズムの解明と実際のパワー半導体の性能実証の両面で検討を進める必要があると考えられる。

以上